

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

关于预计公司 2025 年度申请借款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司 2025 年度拟向银行申请借款额度的情况

鉴于公司业务发展的需要，公司 2025 年度拟向银行或其他法人机构申请总额度不超过人民币 15000 万元的借款额度（最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

公司授权董事长刘志宏全权代表公司办理各项授信手续签批工作及签署授信额度内各项法律文件，包括但不限于授信、借款、融资 及以公司信用、资产等提供担保有关的合同、协议等文件，由此产生全部责任由公司承担。

本次授信有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、审议与表决情况

1、2025 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度申请借款额度的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

2、2025 年 4 月 17 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度申请借款额度的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 申请银行借款额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行借款额度是公司业务及经营的政策所需，通过银行借款的融资方式为公司补充 2025 年资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司的日常经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件

- 1、苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

苏州禧屋新材料科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 18 日